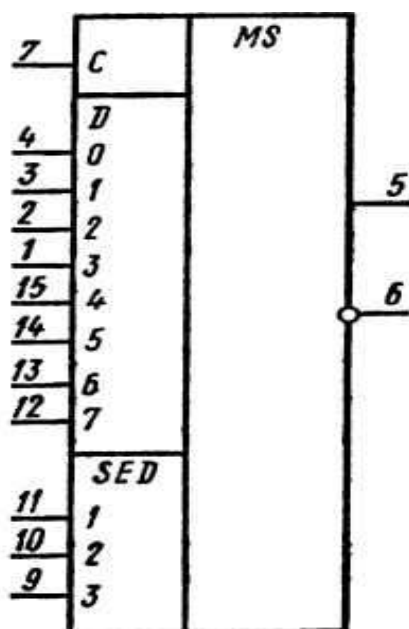


# КР1533КП7, КФ1533КП7, ЭКФ1533КП7

Микросхемы представляют собой селектор-мультиплексор на 8 каналов со стробированием. В зависимости от установленного на выводах 9...11 кода разрешают прохождение сигнала на выходы только от одного из 8 информационных входов. Содержат 195 интегральных элементов. Корпус типа 238.16-1, масса не более 1,2 г и 4307.16-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный D3; 2 - вход информационный D2; 3 - вход информационный D1; 4 - вход информационный D0; 5 - выход Y; 6 - выход  $\bar{Y}$ ; 7 - вход стробирования C; 8 - общий; 9 - вход «выбор данных» SED3; 10 - вход «выбор данных» SED2; 11 - вход «выбор данных» SED1; 12 - вход информационный D7; 13 - вход информационный D6; 14 - вход информационный D5; 15 - вход информационный D4; 16 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533КП7, КФ1533КП7, ЭКФ1533КП7

## Электрические параметры

Номинальное напряжение питания .....	5 В ± 10%
Выходное напряжение низкого уровня .....	≤ 0,4 В
Выходное напряжение высокого уровня .....	≥ 2,4 В
Ток потребления при $U_n = 5,5$ В .....	≤ ЮмА
Входной ток низкого уровня (для одиночного входа) .....	≤  -0,2  мА
Входной ток высокого уровня (для одиночного входа) .....	≤ 20 мкА
Время задержки распространения сигнала при включении:	
- от входов 9, 10, 11 к выходу 5 .....	≤ 35 нс

- от входов 9, 10, 11 к выходу 6.....≤ 30 нс
- от входов 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 к выходу 5.....≤ 26 нс
- от входов 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 к выходу 6.....≤ 18 нс
- от входа 7 к выходу 5 .....≤ 32 нс
- от входа 7 к выходу 6 .....≤ 27 нс

Время задержки распространения сигнала при выключении:

- от входов 9, 10, 11 к выходу 5 .....≤ 35 нс
- от входов 9, 10, 11 к выходу 6.....≤ 30 нс
- от входов 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 к выходу 5.....≤ 26 нс
- от входов 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15 к выходу 6.....≤ 18 нс
- от входа 7 к выходу 5 .....≤ 34 нс
- от входа 7 к выходу 6 .....≤ 30 нс

Емкость входа .....≤ 5 пФ

### **Предельно допустимые режимы эксплуатации**

Напряжение питания .....4,5...5,5 В  
 Входное напряжение низкого уровня .....0...0,8 В  
 Входное напряжение высокого уровня .....2...5,5 В  
 Максимальное напряжение, подаваемое на выход .....5,5 В  
 Температура окружающей среды .....-10...+70 °С

### **Общие рекомендации по применению**

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °С; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °С; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до

места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °С; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °С.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака  $65 \pm 5$  °С.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В  $\pm$  10%, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.